

電子機器2022

トータルソリューション展

6.15 Wed. → 6.17 Fri. 10:00-17:00

東京ビッグサイト 東4-6ホール+会議棟

完全WEB登録制 事前登録 パッと登録! パッと入場!

事前登録のうえ、来場者パスを出しお持ちいただいた方は、当日会場内設置のパスホルダーをピックアップいただくだけでスムーズにご入場いただけます。

来場登録はこちらのWEBから www.jpccashow.com/ 招待状 入場料:1,000円(税込) WEB登録にて無料

www.jpccashow.com

来場のご案内

電子機器トータルソリューション展はWEB登録制となります。事前にWEBにて登録をお願い致します。本招待状をお持ちいただいただけでは入場できませんのでご注意ください。

- STEP.1** 公式ホームページより来場登録へお進みください
- STEP.2** ご登録いただいたメールアドレス宛に、「来場者証」のPDFが添付された登録完了メールが届きます。登録完了メールが届かない場合は事務局までお問合せください。
- STEP.3** 展示会当日、登録完了メールに添付されている「来場者証」をプリントアウトし、四つ折りの状態でご持参ください。パスケースをピックアップ頂き、来場者証を中に入れ、会場入り口にてバーコードをご提示ください。

最新情報はHPをご覧ください

開催概要

JPCA 2022 Show 第51回 国際電子回路産業展

JIEP マクロエレクトロニクス 第39回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC 2022 第23回 実装プロセス/ロジック展

SDGsデバイス展

WIRE Japan Show 電気・光伝送技術展

JEP/TEP Show JEP 全国電子部品流通協会 展示会

E-Textile エレクトロテキスタイル展

Smart Sensing スマートセンシング

InterOpto インターオプト

LED JAPAN エルビウムLED

Imaging Japan イメージングジャパン

Edge Computing エッジコンピューティング

海外協力: 世界電子回路業界団体協議会 (WECC) 加盟団体: CPCA (中国電子回路産業協会)、EIPC (欧州電子回路協会)、ELCINA (印度電子工業会)、HKPCA (香港電子回路協会)、IPC (米国電子回路協会)、IPCA (印度電子回路工業会)、KPCA (韓国電子回路産業協会)、THPCA (タイ電子回路工業会)、TPCA (台湾電子回路協会)

来場者参加企画: ブースコンテスト

来場者参加型企画として昨年実施いたしましたブースコンテストを今年も開催!【ナイスデザイン賞】・【ベスト展示賞】・【特別賞】に値する出展ブースを皆様の投票で決定します。投票していただいた皆様へは品物を進呈いたします。ぜひご参加ください。

来場者参加企画: スタンプラリー

電子機器トータルソリューション展展示ブース企業ブースを全社訪問するとオリジナルグッズがもらえるスタンプラリーを開催します! 台紙は会場にてお配りいたしますので、ぜひブース訪問してください。

ヨロズ相談室 無料 展示ホール内

来場者の皆様から技術的な相談、インターネットでは聞けない疑問等にJPCAコンサルタントがお答えします。電子回路(基板・実装・材料)、専門加工、製造装置、センサ等の技術に関すること、活用方法がわからない方、ヨロズ相談室までぜひご相談ください。

基調講演 プログラム 有料 VIP 無料 来場事前登録より、聴講申込みください。

展示ホール A 会場

聴講料: 会員 ¥10,000円、非会員 20,000円 / 1セッション (聴講料は税込です) ※JPCA 会員 / JIEP 正会員 / 賛助会員 / JARA 正会員 / 賛助法人会員 / JEP / TEP 正会員

6月15日(水)	6月16日(木)	6月17日(金)
SDGs電子デバイス 3000兆円投資のSDGs革命、メタバースが電子デバイスに大インパクト 株式会社タイムズ社 代表取締役会長 泉谷 渉	E-Textile / ウェアラブル 新たな実装技術で創るフレキシブルデバイス「インモールド・フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス (IFHE)」 東北大学 大学院工学研究科 機械機能創成専攻 准教授 福島 聖史	医療 / FLEX 基板 (脳波・アルツハイマー) 伸縮自在なエレクトロニクスで創る「脳波AI解析ツール」 大阪大学 産学科学研究所 教授 岡谷 毅
IoTスマートシティ 都市間連携でデータを共有するスマートシティの未来 ~MCSCCの活動紹介~ 株式会社サイバースマートシティ創造協議会 代表理事 豊崎 雅久	自動車 カーボンニュートラルに向けた自動車の電動化の最新動向 技術研究組合 FC-Cubic 専務理事 大仲 英巳	半導体生産線 東京大学の産学連携最前線 ~半導体強化およびDX推進~ 東京大学 工学部長、大学院工学系研究科長 染谷 隆夫
パワーエレ / 実装 パワー半導体の将来展望 三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所 所長 岩上 徹	スマホ / 内蔵カメラ すべてがなかったインテリジェントな世界へ 株式会社エヌエス 代表取締役 張 松樹	川崎重工グループの水素サプライチェーン構築の取り組み 川崎重工株式会社 代表取締役社長執行役員 橋本 康彦

本展では、コロナ対策を徹底の上、開催いたします。ご来場の皆様には感染症対策を徹底いただき、ご来場予定当日に体調不良の場合はご来場をお控えいただけますようお願いいたします。

- マスクの着用
- 検温の実施
- ソーシャルディスタンス
- 手指消毒
- 咳エチケット
- 大きな声で会話
- 訪問先の記録
- 換気の実施
- こまめな手洗い
- 分散来場
- 余裕を持ったレイアウト
- 三密の回避

会場マップ

ものづくり系 YouTuber ものづくり太郎氏によるトークイベント開催決定! 無料 事前登録不要 展示ホール A 会場

【ものづくり太郎とは?】チャンネル登録数14万件を誇るYouTuber「ものづくり太郎チャンネル」にて検索ください。

6月15日(水)	6月16日(木)	6月17日(金)
	14:30-15:15	「ものづくり太郎、日本の電子回路産業を斬る?」(仮)

JARA 創立50周年記念セミナー 無料 展示会へご来場の方はどなたでも聴講いただけます。事前の聴講申込が必要です。 会議棟1階 101会議室

聴講のお申込みはJISSO PROTECのHPからお願いします <https://www.jissoprotec.jp>

JIEP 最先端実装技術シンポジウム 有料 要事前登録 会議棟6階 605+606会議室<A会場>及び607+608会議室<B会場>

※聴講料は会員区分によって異なります。全額・聴講申込方法はHP上で確認ください。 www.jpccashow.com/show2022/

Time	A会場		B会場	
	Title	15A-1 9:50-12:30	Title	15B-1 10:30-12:15
9:50-10:40	15A-1 高周波に対応する銅配線形成技術 -新シート層を用いた「平滑面」への銅配線の形成	富士川 直 DIC 株式会社 E-2プロジェクト 技術統括マネージャー	15B-1 次世代ノードの鍵を握る3D集積技術の進化と応用に向けた取り組み	井上 史大 横濱国立大学 准教授
10:40-11:35	15A-2 BSGを見据えたフッ素系材料の技術・開発動向	細田 朋也 AGC 株式会社 化学品カンパニー 応用商品開発部 複合材料開発室長	15B-2 最先端ダイ / ウェアラブル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積	山本 憲一 イーワイエー株式会社 代表取締役
11:35-12:30	15A-3 高周波対応・特殊用途のFPC/Semi Flex PWBの採用事例	上田 弘孝 セミコンサルト 代表	15B-3 Overview and Initiatives of TSMC Japan 3DIC R&D Center (仮)	市川 公也 TSMCジャパン 3DIC 研究開発センター 技術 Lead
13:35-14:30	15A-2 次世代情報処理 (AI, IoT等、量子コンピューター) -SDGsも背景にある? 座長:土門 孝彰、青藤 晋	山道 新太郎 日本アイ・ピー・エム 株式会社 代表取締役	15B-4 自動車向け高周波対応の最先端技術	山本 憲一 イーワイエー株式会社 代表取締役
13:35-14:30	15A-21 量子コンピューターの開発と導入	山道 新太郎 日本アイ・ピー・エム 株式会社 代表取締役	15B-5 最先端ダイ / ウェアラブル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積	山本 憲一 イーワイエー株式会社 代表取締役
14:30-15:25	15A-22 Quantum Transformation 量子コンピュータによる社会実装最前線	寺部 雅龍 住友商事株式会社 Quantum Transformationプロジェクト プロジェクト代表	15B-6 最先端ダイ / ウェアラブル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積	山本 憲一 イーワイエー株式会社 代表取締役
15:25-16:20	15A-23 量子コンピュータ開発におけるシリコン集積技術の役割	森 貴洋 産業技術総合研究所 デバイス技術研究部門 主任研究員	15B-7 最先端ダイ / ウェアラブル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積	山本 憲一 イーワイエー株式会社 代表取締役
9:45-10:40	16A-1 5G・6G 通信端末市場と実装技術動向	座長:藤川 幸司、越後 福嗣	16B-1 DX 社会実現に向けて、半導体産業生活はあり得るのか? 何ができるか、何をすべきか	座長:藤川 幸司、内林 秀典
10:40-11:35	16A-2 5Gスマートフォンの見る半導体パッケージと今後の実装技術動向	清水 洋二 株式会社エヌエス 代表	16B-2 最先端ダイ / ウェアラブル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積	山本 憲一 イーワイエー株式会社 代表取締役
11:35-12:30	16A-3 (仮) 次世代パッケージ FOLP の特徴と適用市場	鈴木 敬史 アイエレクトロニクス 第1技術部 FOLP 事業部 部長代理	16B-3 カarbonニュートラルの実現に向けた新戦略	座長:三宅 敏広、土門 孝彰
13:35-14:30	16A-2 CASE に向けた車載機器実装技術の最新動向	座長:三宅 敏広、油田 浩規	16B-4 最先端ダイ / ウェアラブル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積	山本 憲一 イーワイエー株式会社 代表取締役
14:30-15:25	16A-21 日中韓の分解から読み取れる2025年のEV車とそれに関する(パワ)エレクトロニクス実装技術最前線	山本 憲一 イーワイエー株式会社 代表取締役	16B-5 最先端ダイ / ウェアラブル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積	山本 憲一 イーワイエー株式会社 代表取締役
15:25-16:20	16A-22 ワイドギャップ半導体向けパワーエレクトロニクス技術動向	杉本 昭雄 大分大学 工学部 教授	16B-6 最先端ダイ / ウェアラブル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積	山本 憲一 イーワイエー株式会社 代表取締役
9:45-10:15	17A-1 新たな記憶・実装がもたらすスマート材料最前線 (仮)	座長:本多 進、小岩 一郎	17B-1 e-Axle (イーアクスル) の最新動向 (仮)	高澤 洋史 株式会社タイムズ社 電子デバイス産業新聞 編集長 記者
10:15-11:05	17A-2 女子大工学部で取り組むフットパワールールウェアシステムの研究	才藤 直樹 奈良女子大学 工学系 教授 大阪大学大学院 基礎工学研究科 特任教授	17B-2 自動車用エレクトロニクス技術動向 ~電気自動車と自律運轉に向けて~	宇都宮 久徳 インターコネクション・テクノロジー株式会社 代表取締役
11:05-11:55	17A-3 e-テキスタイル、導電糸とは? (仮)	菅山 秀樹 福井工業技術センター 新産業創出研究部 ウェアラブル技術研究グループ 主任研究員	17B-3 全固体電池の最新動向 (仮)	一杉 太郎 東京大学 理学系研究科化学専攻 教授
11:55-12:30	17A-4 衣服ウェアラブルデバイスによるバイタルセンシング ~心電データから心身状態はとどこまで読み解けるか?~	前田 郷司 東洋紡株式会社 総合研究所 主幹	17B-4 Beyond 5G への挑戦、新しい実装技術への取り組みとソリューションの提案	座長:西田 秀行
13:35-14:30	17A-21 オートバイロケット型統合 ECU に見る実装技術	清水 洋二 株式会社エヌエス	17B-5 最先端ダイ / ウェアラブル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積	山本 憲一 イーワイエー株式会社 代表取締役
14:30-15:25	17A-22 車載 E/E-アーキテクチャの進化に向けた ECU 実装技術とプリント配線板技術	戸田 光昭 株式会社エヌエス 代表	17B-6 最先端ダイ / ウェアラブル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積	山本 憲一 イーワイエー株式会社 代表取締役
15:25-16:20	17A-23 微細化するピッドアップ基板マイクローピアの信頼性問題	菅沼 克昭 大阪大学 フレキシブル3D実装協働研究所 特任教授・所長	17B-7 最先端ダイ / ウェアラブル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積	山本 憲一 イーワイエー株式会社 代表取締役

PROTEC セミナー 無料 会議棟7階 703会議室

聴講申込方法はJISSO PROTECのHPよりご確認ください <https://www.jissoprotec.jp>

6月15日(水)	6月16日(木)	6月17日(金)
10:30-11:30	10:30-11:30	10:30-11:30
12:00-13:00	12:00-13:00	12:00-13:00
13:30-14:30	13:30-14:30	13:30-14:30
15:00-16:00	15:00-16:00	15:00-16:00

熱関連セミナー 無料 事前登録不要 会議棟6階 610会議室

6月17日(金)	
13:00-14:00	調整中

製品安全セミナー 無料 事前登録不要 会議棟6階 610会議室

6月16日(木)	
13:30-14:30	製品安全セミナー

JPCA プリント配線板技術ロードマップセミナー 有料 要事前登録 会議棟7階 701+702会議室

6月16日(木)	
13:00-13:50	最新半導体パッケージ技術動向
14:00-14:30	最新半導体市場動向
14:30-15:00	最新機能集積配線板技術動向
15:10-16:00	最新高速通信機器システム
16:10-17:00	最新高速通信機器用プリント基板

ぶりんとばんじゅくセミナー 無料 事前登録不要 会議棟6階 609会議室

6月15日(水)	
11:00-12:00	プリント配線板全般の基礎「ぶりんとばんじゅくI」をもとに解説
13:00-14:00	プリント配線板設計の基礎「ぶりんとばんじゅくII」をもとに解説
14:30-15:30	フレキシブル配線板の基礎「ぶりんとばんじゅくIII」をもとに解説

ダントツのものづくりセミナー 無料 事前登録不要 展示ホール B 会場

6月15日(水)	6月16日(木)	6月17日(金)
13:00-13:45	13:00-14:00	13:00-14:00
13:45-14:30	14:00-14:45	14:00-14:45
14:30-15:30	14:40-15:10	14:45-15:30
15:30-16:30	15:10-15:55	15:30-16:00
15:55-16:40	15:55-16:40	

日本の電子回路産業発行報告会 無料 事前登録不要 会議棟6階 610会議室

6月16日(木)	
10:15-11:15	電子回路産業の現状と将来展望について

PWB コンサルタントスキルアップセミナー 無料 要事前登録 会議棟6階 609会議室

6月17日(金)	
15:00-16:45	PWB コンサルタントスキルアップセミナー

※本招待状に掲載のプログラム他は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。講演当日は早目の受付にご協力をお願いいたします。

Table with 4 columns: Time, Title, Speaker, and Venue. Rows include topics like '高周波化対応次世代BTレジン材料の紹介', 'シミュレーションとAIでプリント基板設計に革命', '世界最先端のUVセンサ技術とその応用', etc.

Table with 2 columns: Time and Content. Keynote Speech on June 15th (Water) and June 16th (Gold) regarding IoT and smart sensing.

Table with 2 columns: Time and Content. Academic presentations on June 16th (Gold) and June 17th (Gold) regarding TDS analysis, material synthesis, and optical devices.

Table with 3 columns: Time, Title, and Speaker. Seminars on June 15th (Water) covering topics like 'ダイナミックイメージコントロールの新展開' and '人と機械が協調する社会の実現に向けた画像センシング技術'.

Table with 2 columns: Time and Content. Forum on June 15th (Water) regarding THz technology and device development.

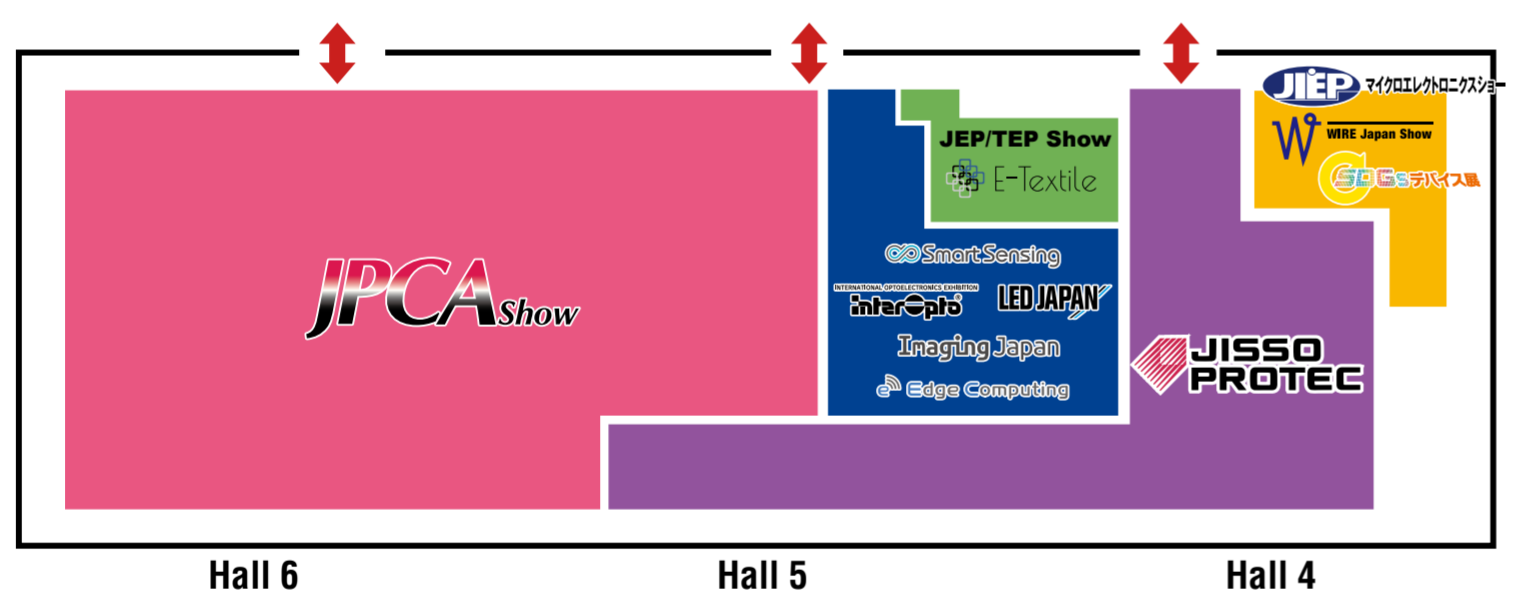
Table with 2 columns: Time and Content. Seminar on June 16th (Gold) regarding LED/LD technology and photonic devices.

Table with 2 columns: Time and Content. Mini-seminar on June 17th (Gold) regarding photonic technology and device applications.

Table with 2 columns: Time and Content. 3D-MID pavilion seminar on June 15th (Water) and June 16th (Gold) regarding MID technology.

Table with 2 columns: Time and Content. JEP/TEP seminar on June 16th (Gold) regarding manufacturing and AI solutions.

Table with 2 columns: Time and Content. E-Textile Initiative seminar on June 17th (Gold) regarding textile products and technology.



JPCA Show AWARDS 2022 授賞式. Text describing the award ceremony for excellence in products and technology.

半導体 オブ・ザ・イヤー 2022 受賞製品・技術発表. Text regarding the semiconductor award ceremony on June 15th.

Table listing exhibitors by category: スポンサー企業 (Sponsor), コールト (Co-located), シルバー (Silver), フロント (Front), プリント配線板技術展 (PCB Technology), JPCA Show, マイクロエレクトロニクスショー (Microelectronics Show), eX-tech, 3D-MIDパビリオン (3D-MID Pavilion), and Edge Computing.

Table listing exhibitors by category: 武蔵エンジニアリング (Mitsubishi Engineering), Smart Sensing, All about Photonics, SDGsデバイス展 (SDGs Device Exhibition), WIRE Japan Show, JEP/TEP Show, JISSO PROTEC, E-Textile, and Edge Computing.